

粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人 (联席主承销商):广发证券股份有限公司 联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司

特别提示

粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令（第228号），以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令（第205号））、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026年修订）》（《深证上（2026）552号》，以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（《深证上（2018）279号》，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（《深证上（2025）224号》，以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》（《深证上（2020）343号》）（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）、中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发（2023）18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发（2025）57号，以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者适当性评价和管理指引》（《中证协发（2024）277号》）等有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行的保荐人（联席主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“广发证券”）。本次发行的联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）。广发证券和国泰海通合称“联席主承销商”。

截至《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）公告日，粤芯半导体尚未盈利且存在累计未弥补亏损风险，敬请投资者关注。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行；初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定；网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》

粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐人 (联席主承销商):广发证券股份有限公司 联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司

粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所以（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕2196号）。

本次发行的保荐人（联席主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“广发证券”）。本次发行的联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）。广发证券和国泰海通合称“联席主承销商”。

经发行人和联席主承销商协商确定，本次初始公开发行股票数量为51,264.6000万股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为17.81%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量15.00%（不超过7,689.6000万股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至58,954.2000万股，约占公司发行后总股本的比例为19.95%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售股票将通过向参与本次发行的部分战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

截至《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）公告日，粤芯半导体尚未盈利且存在累计未弥补亏损风险，敬请投资者关注。

本次发行价格12.01元/股对应的发行人未行使超额配售选择权时2025年摊薄后静态市销率为13.39倍，若全额行使超额配售选择权后本次发行后市销率为13.74倍，低于可比上市公司2025年静态市销率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司《招股意向书》中披露的风险因素，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。截至2026年9月18日（T-4日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为73.18倍。

本次发行适用由中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令（第228号））、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令（第205号））、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026年修订）》（《深证上（2026）552号》）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（《深证上（2025）224号》）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（《深证上（2018）279号》）、中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发（2023）18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发（2025）57号）和《首次公开发行证券网下投资者适当性评价和管理指引》（《中证协发（2024）277号》，请投资者关注相关规定的变化。

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行；初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行；网上发行通过深交所交易系统进行。

等相关规定。

本次发行价格12.01元/股对应的发行人未行使超额配售选择权时2025年摊薄后静态市销率为13.39倍，若全额行使超额配售选择权后本次发行后市销率为13.74倍，低于同行业可比上市公司2025年静态市销率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行流程、超额配售选择权、网下剔除比例规定、网上网下申购及缴款、回拨机制、网下限售期安排、中止发行、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价后，协商一致将拟申购价格高于13.54元/股（不含13.54元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为13.54元/股，且拟申购数量小于2,130万股（不含2,130万股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为13.54元/股，拟申购数量等于2,130万股，且申报时间晚于2026年9月18日14:22:26:910（不含2026年9月18日14:22:26:910）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除483个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1,816,260万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量60,549,350万股的2.9996%。剔除部分的配售对象不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.01元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2026年9月24日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年9月24日（T日），其中，网下申购时间为9:30–15:00，网上申购时间为9:15–11:30、13:00–15:00。

3、本次发行价格为12.01元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值13.1669元/股。

2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价后，协商一致将拟申购价格高于13.54元/股（不含13.54元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为13.54元/股，且拟申购数量小于2,130万股（不含2,130万股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为13.54元/股，拟申购数量等于2,130万股，且申报时间晚于2026年9月18日14:22:26:910（不含2026年9月18日14:22:26:910）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除483个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1,816,260万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量60,549,350万股的2.9996%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.01元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2026年9月24日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年9月24日（T日），其中，网下申购时间为9:30–15:00，网上申购时间为9:15–11:30、13:00–15:00。

4、发行人与联席主承销商协商确定的发行价格为12.01元/股，本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值。

本次发行初始战略配售发行数量为25,632.3000万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。本次发行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为25,632.3000万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的43.48%。初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

5、超额配售选择权：发行人授予广发证券超额配售选择权，广发证券将按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模15.00%（7,689.6000万股）的股票，即向投资者配售，总计初始发行规模115.00%（58,954.2000万股）的股票，最终超额配售情况将在2026年9月28日（T+1日）《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。超额配售股票将通过向参与本次发行的部分战略配售投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。广发证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。

6、本次发行价格12.01元/股，此价格对应的市销率为：

（1）11.00倍（每股收入按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

（2）13.39倍（每股收入按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以超额配售选择权行使前本次发行后总股本计算）；

根据最终确定的价格，本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者组成。参与战略配售的投资者认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

保荐人相关子公司跟投由广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）实施。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰海通君享创业板粤芯半导体1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“粤芯半导体1号资管计划”）和国泰海通君享创业板粤芯半导体2号战略配售集合资产管理计划（以下简称“粤芯半导体2号资管计划”）。根据最终确定的价格，广发乾和最终战略配售股份数量为1,025.2920万股，占本次发行股份数量的2.00%（发行人为未盈利企业，保荐人相关子公司按照相关规定参与本次发行的战略配售）；粤芯半导体1号资管计划最终战略配售股份数量1,690.1078万股，占本次发行股份数量的3.30%；粤芯半导体2号资管计划最终战略配售股份数量82.5312万股，占本次发行股份数量的0.16%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量22,834.3690万股，占本次发行股份数量的44.54%。

本次发行初始战略配售发行数量为25,632.3000万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为25,632.3000万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的43.48%。初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

本次发行最终采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。

4、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

本次网下发行部分采用约定限售方式，安排网下发行证券设定不同档位的限售比例或限售期。发行人和联席主承销商协商确定本次的限售档位为三档：

（1）档位一（投资者报价时对应申报限售期9个月、限售比例60%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的60%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起9个月。即每个配售对象获配的股票中，40%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；60%的股份限售期为9个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开始计算。

（2）档位二（投资者报价时对应申报限售期6个月、限售

（3）13.74倍（每股收入按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以若超额配售选择权全额行使后本次发行后总股本计算）。

7、本次发行价格为12.01元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2026年9月18日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为73.18倍。

截至2026年9月18日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4日 股票收盘价 (元/股)	T-4日 市值 (亿元)	2025年营业收入(亿元)	对应市销率 (倍)
689891.SH	中芯国际	122.00	10,445.96	673.23	15.52
688347.SH	华虹公司	234.00	4,512.68	172.91	26.10
688469.SH	芯联集成-U	8.72	730.97	81.80	8.94
688249.SH	晶合集成	36.75	821.28	108.85	7.54
688172.SH	燕东微	46.91	669.70	18.33	36.53
平均值（剔除极值）					14.52

数据来源：Wind资讯，数据截至至2026年9月18日（T-4日）。

注1：市销率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：市销率平均值计算剔除了极值（燕东微）。

本次发行价格12.01元/股对应的发行人未行使超额配售选择权时2025年摊薄后静态市销率为13.39倍，若全额行使超额配售选择权后本次发行后市销率为13.74倍，低于可比上市公司2025年静态市销率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司《招股意向书》中披露的风险因素，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本次发行定价合理性说明如下：

与行业内其他公司相比，粤芯半导体在以下方面存在一定优势：

① 平台优势：“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体的产业布局

公司主要从事集成电路制造环节中的12英寸晶圆代工业务，具备集成电路、功率器件等多元化产品平台的工艺研发与制造能力，涵盖MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho等工艺技术平台。公司成立以来，紧密贴合模拟芯片行业品类多样化的产品特点，持续丰富自身产品组合，目前已具备较完整的成熟节点工艺制程，可为客户提供180–55nm等多个制程节点的特色晶圆代工服务，产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等。

在技术创新方面，公司于2024年底成功推出12英寸90nm SiPho工艺技术平台。截至本公告签署日，公司的硅光工艺技术平台累计投产片量已超过7,000片；根据Frost & Sullivan数据，截至2026年4月末，公司是中国大陆唯一具备12英寸硅光晶圆大规模量产能力的企业。公司的硅光产品涵盖400G、800G及1.6T高速可插拔硅光模块应用，与国际先进水平相当。同时，公司与业界先进水平保持同步，开展近封装光学（NPO）的工艺制造技术研发，目前正在导入3.2T NPO产品。未来，公司将进一步开展65nm硅光及光

比例40%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的40%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，60%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；40%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开始计算。

（3）档位三（投资者报价时对应申报限售期6个月、限售比例20%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的20%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，80%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；20%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开始计算。

公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品和合格境外投资者资金（A类投资者）可以自主申购上述三种档位中的不同限售档位，其他投资者（B类投资者）仅可申购档位三。申购限售档位为投资者在初步询价阶段提交的限售档位，如申购阶段与初步询价阶段提交限售档位不一致，将以初步询价阶段为准。限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开始计算。

在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格、申购数量和申购限售档位（包括“限售期”和“限售比例”）。一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期和限售比例安排；如果申购档位一、档位二的投资者较少，初步配售后无法满足整体限售比例要求，则发行人和联席主承销商将相应提高档位三的限售比例、直至满足网下发行部分整体限售比例不低于40%。对于选择档位三的网下投资者，其最终限售比例及限售期限以《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）披露的内容为准。

战略配售股份限售安排详见本公告“三、战略配售”。

5、发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股票数量为51,264.6000万股，占公司发行后总股本的比例约为17.81%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量15.00%（不超过7,689.6000万股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至58,954.2000万股，约占公司发行后总股本的比例为19.95%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售股票将通过向参与本次发行的部分战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

(下转A18版)

电融合工艺的研发和量产，实现从可插拔光模块向近封装光学（NPO）、光电共封装（CPO）的演进，以满足市场对硅光及光电融合芯片在制造技术及代工产能上的急迫需求。公司是国内极少数能够同时提供“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体代工服务的集成电路制造企业。

②模式优势：打造“终端、设计与制造”的协同优化模式 晶圆代工作为半导体行业垂直化、专业化分工的关键环节，是半导体制造产业的核心构成。标准化工艺的晶圆代工模式在数字芯片等领域具备显著的效率和成本优势，但对模拟芯片并非最优。其主要原因在于模拟芯片的性能（如低失真、高信噪比、可靠性与稳定性）更依赖于工艺创新与器件优化，而非仅通过制程尺寸缩减，需通过特色工艺与设计的深度融合实现。

公司坚持特色工艺路线，基于丰富的产品组合、深厚的技术积淀，能够以高质量的标准，开发具有市场竞争力的工艺技术平台。同时，公司深度协同芯片设计公司及终端客户，推动终端、设计与制造协同优化的创新模式，共同探讨工艺制造与设计优化的解决方案，积极帮助客户实现其特定设计目标和工艺需求，增加其产品差异化和竞争力，逐步突破国内高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片的技术瓶颈。该合作模式增强了客户粘性，提升了公司的品牌影响力，奠定了公司未来持续快速发展的基础，是公司市场竞争优势的重要体现。

③ 区位优势：践行“终端牵引设计、设计带动制造”的创新思路

粤港澳大湾区是全国乃至全球电子产业终端厂商最集中的区域之一，汇聚智能移动终端、新一代电子信息、新能源汽车、智能机器人、超高清视频显示、智能家电等万亿级产业集群，拥有从芯片设计、终端制造到市场应用的完备产业链基础。随着全球产业链的重构，中国厂商在智能移动终端、汽车电子、智能机器人、人工智能等高科技领域的重要性逐渐凸显，终端定义需求，终端牵引设计，已经逐渐成为产业协同推动创新技术商业落地的高效转化模式。

公司发挥贴近终端客户，掌握市场动态，积极构建生态的区位优势，通过深度协同区域内的上游集成电路设计厂商与下游终端应用企业，打造紧密的产业联盟，打通从设计到制造、再到应用的关键环节，以高效协同、快速响应的服务模式，灵活的经营策略和充分的产能支持，满足客户的多样化需求，激发产业的创新活力。

公司与总部位于大湾区的全球指纹识别芯片龙头企业紧密合作，成功攻克硅基超声波指纹识别芯片的制造技术难题，实现了国内该领域的技术突破，打破境外厂商在该领域长期垄断地位，使公司成为国内少数具备硅基超声波指纹识别芯片大规模量产能力的晶圆代工企业之一。目前，该创新方案已成功导入VIVO、OPPO等多家扎根大湾区的知名手机品牌。

④ 人才团队优势：国际化专业人才梯队与市场化管理机制，打造竞争优势

公司的技术及管理专家来自全球各地，具有多家国际知名半导体企业的任职经历，核心管理团队更拥有20余年的深厚行业积淀。公司具备强大的企业管理及技术研发能力，并已构建起合理的人才梯队。截至2025年12月31日，公司员工总数达1,943人，硕士及以上学历人员占比为20.48%，拥有3年及以上半导体行业经验者超过60%。

在治理结构方面，公司拥有多元化和专业化的股东背景、完善的公司治理结构、市场化的经营管理机制，赋予了公司高度的灵活性，使其能够快速响应市场需求变化，精准选择产品和发展路径，高效制定商业决策。此外，公司已对核心骨干员工实施了股权激励计划，这不仅显著提高了核心团队的稳定性，更有效激发了员工的创新创造活力，为公司人才优势的巩固与长期可持续发展奠定了坚实基础。

(下转A18版)